# SICK auf der SPS 2023: Gemeinsam Lösungen finden, gemeinsam Werte schaffen

Lösungskompetenz für vielfältige Industrien und Applikationen – mit smarten Sensoren, ganzheitlichen Safety- und Automatisierungslösungen sowie digitalen Services

Waldkirch/Düsseldorf, im September 2023 – Unter dem Leitmotiv „Solutions for your industry – We create value together“ präsentiert sich SICK auf der SPS 2023 (14. – 16. November, Halle 7A, Stand 340) als innovativer Lösungsanbieter und kompetenter Wertschöpfungspartner mit Know-how in zahlreichen Kernindustrien. Das Spektrum reicht von smarten Sensoren und Sensorsystemen für die Fabrikautomation, Intralogistik und Sicherheitstechnik über Visionlösungen rund um die Fertigung und Montage von Hochvoltspeichern für Elektrofahrzeuge bis hin zu smarten Services zur Druckluftüberwachung und deren mögliche Integration in Energiemanagementsysteme. Mit dem Ziel, den Standbesucher punktgenau auf seine individuellen Herausforderungen hin informieren zu können, hat SICK sein Lösungsangebot in die sechs Cluster Automotive & Electronics, Consumer & Logistics, Industrial Robots, Machines & Motion, Mobile Platforms und Transparency gegliedert – und auf die Einteilung des Messestandes übertragen.

Die in dieser Form präsentierten Lösungen sind das Ergebnis enger Partnerschaften: sie basieren auf dem übereinstimmenden Verständnis mit den Kunden hinsichtlich ihrer Branchen, individuellen Problemstellungen und Anforderungen.

**Miniatur-Lichtschranke-Familie W4S der neuesten Generation**

Die neue Miniatur-Lichtschranke W4S der neuesten Generation komplettiert die vielseitige W4-Baureihe. In ihrem schmalen und robusten Vistal-Gehäuse mit seitlichem Lichtaustritt eignen sich die Einweg- und Reflexionslichtschranken sowie die Reflexionslichttaster besonders für enge Einbausituationen. Ein besonderes Highlight der Produktfamilie sind die sogenannten „Optical Experts“: sie sind speziell für herausfordernde Aufgabenstellungen konzipiert, beispielsweise die Detektion unterbrochener, unebener, sehr flacher, durchsichtiger, reflektierender oder kontrastreicher Oberflächen. Mit ihrer derzeit wohl besten Fremdlichtunterdrückung am Markt gewährleisten alle W4S-Sensoren höchste Verfügbarkeit und Prozessstabilität. IO-Link und Smart-Sensor-Funktionen zur Sensorüberwachung und -diagnose schaffen die Verbindung in die digitalisierte Maschinen- und Applikationswelt – und bieten so ein hohes Maß an Zukunftssicherheit.

# Distanzsensor DT80 mit IO-Link bietet höchste Präzision auch auf große Entfernungen

Hohe Reichweiten bis 80 Meter, besondere Präzision und Wiederholgenauigkeit im Nahbereich, ein völlig neues, bedienerfreundliches Usability-Konzept mit symbolunterstütztem Sensordisplay – Icons inside – und platzsparende Gehäusebauformen in den Schutzarten IP65 und IP67 sind nur einige der besonderen Merkmale des neuen Distanzsensors DT80. Mit der Summe seiner Eigenschaften erschließt der DT80 viele neue stationäre und mobile Applikationsbereiche, u. a. in der Stahl- und Metallerzeugung, im Sonder- und Kommunalfahrzeugbau, in mobilen Maschinen, in Hafenanlagen oder in der Konsumgüterindustrie. So wird der Sensor beispielsweise auf selbstfahrenden Gabelstaplern zur äußerst wiederholgenauen Höhenpositionierung der Lastaufnahmegabeln eingesetzt. Dies trägt nicht nur zur Steigerung der Betriebseffizienz und -sicherheit bei, sondern ermöglicht auch die Integration in automatisierte Prozesse sowie die Aufnahme von Betriebsdaten und deren Übertragung per IO-Link zur weiteren Verwendung.

**Ruler3000: neue kompakte Baugrößen vereinen hohe Genauigkeit mit höchster Messgeschwindigkeit**

**SICK erweitert die Familie der 3D-Streaming-Kameras Ruler3000 um die drei platzsparend integrierbare Kompaktkameras** Ruler3002, Ruler3004 und Ruler3010. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 46 kHz, garantierten Sichtfeldern bis zu 26,6 mm sowie kurzen Belichtungszeiten aufgrund ihrer leistungsstarken blauen 3R-Lasersenders eröffnen sie neue Möglichkeiten, auch kleinste Details zuverlässig zu erfassen – wie dies beispielsweise bei der Prüfung von Elektronik- und Konsumgüterbaugruppen, Leiterplatten und Halbleitern oder in der Produktion und Montage von Hochvoltspeichern erforderlich ist. Dabei erreichen die 3D-Kameras nicht nur eine hervorragende Wiederholgenauigkeit auf hellen, spiegelnden und metallischen Oberflächen, sondern eine neue, zum Patent angemeldete Surface+-Technologie fügt eine weitere Bilddimension hinzu, die selbst den kleinsten Kratzer auf glatten, glänzenden Metalloberflächen wie Batteriegehäusen sichtbar macht. Die benutzerfreundliche Stream-Setup-Schnittstelle von SICK erleichtert die Maschinenintegration. Die SICK GenIStream API erleichtert die Programmierung für C#- und C++-Anwender. Die Konformität mit GigEvision und GenICam eröffnet den Plug-and-Play-Zugang zu Drittanbieter-Software wie HALCON und LabVIEW. Mit der AppSpace-Softwareplattform von SICK können Entwicklern eine breite Palette an Bildverarbeitungswerkzeugen und Anwendungsbeispielen nutzen.

**Mit Goods-Receipt-Komplettlösung auch höchste Paketaufkommen sicher beherrschen**

Weniger Suchaufwand, störungsfreie Prozesse, Vermeidung unnötiger Kosten – dies und mehr ermöglichen intelligente Lösungen von SICK für die automatisierte Warenannahme. Basierend auf einer digitalen Plattform zur Sammlung, Verarbeitung und Bereitstellung packstückrelevanter Daten schaffen die Goods-Receipt-Lösungen dank moderner Scanningtechnologien vollständige Echtzeit-Transparenz im Wareneingang – und machen so selbst höchste Paketaufkommen sicher beherrschbar. Um individuellen Anforderungen an die Identifikation und Sortierung von Sendungen im Wareneingang gerecht zu werden, stehen die Systemlösungen für die automatisierte Warenannahme in skalierbaren Automatisierungsgraden zur Verfügung – von der manuellen Paketerfassung bis zur vollautomatisierten Paketannahme mit direkter Integration in kundenseitige Förder- und Sortieranlagen.

**Systemlösungen für Sicherheit bei der Produktion und Montage von Hochvoltspeichern**

Mit dem Foreign Object Detection System (FOS) und dem Static Hotspot Detection System (SHD) präsentiert SICK zwei laserbasierte Systemlösungen für die Fremdkörperdetektion und für die Früherkennung überhitzter Oberflächen von Hochvoltspeichern. Während das FOS beim Einbau der Batterie in die Karosserie eine berührungslose Prüfung der Batterieoberfläche auf das Vorhandensein von Fremdkörpern durchführt, erkennt das SHD mit Hilfe von Infrarotkameras überhitzte Bereiche auf den Oberflächen der Hochvoltspeicher. Damit gewährleisten sie einen effizienten Schutz vor möglichen Kurzschluss-, Brand- und Explosionsgefahren an Elektrofahrzeugen oder in der Produktionsanlage – und verhindern so Personen- und Sachschäden, Materialverlust, Anlagenstillstände und Produktionsausfall.

**Mit digitalem Service Druckluftkosten um bis zu 30 Prozent reduzieren**

Die Monitoring Box FTMg Premium von SICK ist ein neuer digitaler Service für das Druckluftmonitoring. Über die kontinuierliche Druckluftüberwachung hinaus ermöglicht es die Cloud Lösung des Field Analytics Portfolios von SICK, Verbrauchsverluste durch Ineffizienzen in Maschinen oder Prozessen zu identifizieren sowie Leckagen frühzeitig zu detektieren und per Alarm zu melden. Zudem ist der digitale Service in der Lage, Druckluftverbraucher verbrauchs- und kostenmäßig miteinander zu vergleichen und so Optimierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Unter dem Strich können Produktionsplaner, Energiemanager und Instandhalter mit der Monitoring Box FTMg Premium die Druckluftkosten in der Produktion um bis zu 30 % reduzieren – und dabei gleichzeitig den CO2-Footprint verkleinern und Servicearbeiten effizienter gestalten.



*Unter dem Leitmotiv „Solutions for your industry – We create value together“ präsentiert sich SICK auf der SPS 2023 als innovativer Lösungsanbieter und kompetenter Wertschöpfungspartner mit Know-how in zahlreichen Kernindustrien.*

 **Ansprechpartnerin:**

Melanie Jendro │PR Managerin │melanie.jendro@sick.de
+49 7681-202-4183 │+49 151 7410 3531

SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt fast 12.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Konzernumsatz von rund 2,2 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com.